

В. В. СЫЧЕВ, В. А. АЛЬТОВ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКА
В КОМБИНИРОВАННЫХ СВЕРХПРОВОДНИКАХ

(Представлено академиком В. А. Кириллиным 20 XI 1970)

Современная теория комбинированных сверхпроводников базируется на модели, предложенной З. Стекли^(1, 2). При формулировке исходных уравнений^(1, 2), описывающих состояние комбинированного проводника, в качестве первого приближения принято, что доля тока, идущая по сверхпроводящей части комбинированного проводника, равна критическому току сверхпроводника I_{kp} при данной равновесной температуре T комбинированного проводника. Такое допущение позволило построить достаточно простую и наглядную модель, приводящую к результатам, качественно пригодным для любых практических приложений. Последующие работы, в которых теория З. Стекли была обобщена с учетом перехода к пленочному режиму кипения гелия⁽³⁾ и затем с учетом влияния температурной зависимости сопротивления подложки⁽⁴⁾, также основаны на этом допущении.

В условиях деления тока в комбинированном проводнике между сверхпроводником и подложкой сверхпроводник находится в особом, так называемом резистивном, состоянии⁽⁵⁾. При этом важно отметить, что поскольку подложка и сверхпроводник в комбинированном проводнике могут рассматриваться как проводники, включенные параллельно, очевидно в условиях деления тока будет иметь место падение напряжения на этом сверхпроводнике V , равное падению напряжения на подложке:

$$V = f\varrho / A = (I_s - I_{kp})R_{pe}, \quad (1)$$

где I — полный ток в проводнике, f — доля тока, перешедшая в подложку, ϱ / A — сопротивление подложки на единицу длины, $I_s = (1 - f)I$ — ток в сверхпроводнике, $R_{pe} = (dV / dI)_{T=\text{const}}$ — резистивное сопротивление сверхпроводника в расчете на единицу длины.

Очевидно, если бы в условиях деления тока между сверхпроводником и подложкой по сверхпроводнику протекал ток $I_{kp}(T, H)$, падение напряжения на сверхпроводнике отсутствовало бы; между тем это отличное от нуля падение напряжения поддерживается на сверхпроводнике включенной параллельно ему подложкой. В рассматриваемых условиях по сверхпроводнику течет ток, величина которого превышает величину критического тока для данной равновесной температуры проводника T

$$\Delta I_s = I_s - I_{kp}. \quad (2)$$

Учет этой поправки при выводе уравнений Стекли был выполнен в работе⁽⁶⁾ и привел к выражениям, отличающимся от них дополнительным членом x в знаменателе правой части уравнений (3) — (5)

$$f = (i - 1) / [i(1 - ai + x)], \quad (3)$$

$$VA / (\varrho I_c) = (i - 1) / (1 - ai + x) = fi \quad (4)$$

— безразмерное напряжение на единицу длины проводника;

$$\tau = ai(i - 1) / (1 - ai + x) = fai^2 \quad (5)$$

безразмерная температура проводника;

здесь $i = I / I_c$ — безразмерная сила тока в комбинированном проводнике, $\tau = (T - T_b) / (T_c - T_b)$ — безразмерная температура комбинированного проводника, $a = \rho I_c^2 / [APh(T_c - T_b)]$ — безразмерный параметр, обычно именуемый критерием стабильности Стекли, T_b — температура гелиевой ванны, P — охлаждаемый периметр проводника, h — коэффициент теплоотдачи с поверхности проводника в гелиевую ванну, $x = \rho / (AR_{\text{под}})$ — отношение сопротивления подложки ($R_{\text{под}} = \rho / A$) к сопротивлению сверхпроводящей части комбинированного проводника, находящейся в резистивном состоянии.

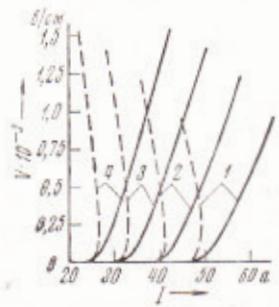


Рис. 1

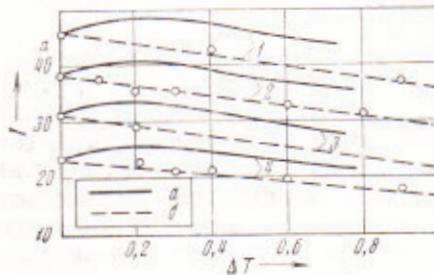


Рис. 2

Рис. 1. Зависимость $V(I_s)$ при различных H : 1 — 20 кэ; 2 — 30; 3 — 40; 4 — 50 кэ;

Рис. 2. Зависимость $I_s(H, T)$ (а) и $I_{\text{кр}}(H, T)$ (б) при различных H : 1 — 20 кэ; 2 — 30; 3 — 40; 4 — 50 кэ

Поскольку в реальных комбинированных проводниках действует ряд факторов (нелинейность коэффициента теплоотдачи h , наличие теплового и электрического сопротивления на границе сверхпроводника и подложки, нелинейность вольт-амперной характеристики сверхпроводника в резистивном состоянии при $T = \text{const}$ и др.), учет которых в теоретическом рассмотрении представляется затруднительным, оставался открытый вопрос о степени влияния параметра x на распределение тока в комбинированных сверхпроводниках. В этой связи нами было проведено экспериментальное исследование распределения тока в технических комбинированных проводниках в условиях деления тока между сверхпроводником и подложкой.

Методика эксперимента состояла в следующем. Исследуемый образец комбинированного проводника длиной 10—15 см навивался на фторопластовый каркас $\phi = 2,5$ см, выполненный в виде звездочки. Таким образом, образец соприкасался с поверхностью каркаса лишь в отдельных точках (на зубцах звездочки) и, следовательно, можно считать, что теплоотдача с поверхности образца осуществлялась к большому объему жидкого гелия. Исследуемый образец снабжен потенциальными отводами, расположеннымими на расстоянии 1 см друг от друга, что позволяло регистрировать резистивное сопротивление каждого участка, а следовательно, распределение температуры вдоль проводника. Образец помещался внутрь сверхпроводника соленоида, который являлся источником внешнего магнитного поля. Единичный участок, на котором регистрировалось падение напряжения, выбирался в той области образца, где распределение температуры было наиболее равномерным. Это позволило максимально приблизить условия опыта к модели Стекли. Эксперимент проводился следующим образом. Ток в цепи экспериментального образца постепенно повышался и по достижении критического тока $I_{\text{кр}}$ в образце появлялась резистивная зона, быстро распространяющаяся вдоль всего образца. Условие изотермичности образца устанавливалось по равенству падений напряжения на единичных участках. Затем постепенно увеличивая ток в цепи образца, получали на двухкоординатнике вольт-амперную характеристику исследуемого проводника.

На рис. 1 представлены вольт-амперные характеристики (сплошные линии) семижильного комбинированного проводника, снятые при различных значениях внешнего магнитного поля в условиях пузырькового режима кипения. Проводник внешним диаметром 0,3 мм представляет собой медную матрицу с семью NbTi жилами диаметром $\sim (0,07-0,10)$ мм. Верхние точки линий $H = \text{const}$ на вольт-амперной диаграмме соответствуют моменту наступления кризиса кипения. Дальнейшее повышение тока в образце приводило к неконтролируемому переходу комбинированного проводника в нормальное состояние (на рис. 1 не показано), когда весь ток течет по подложке, т. е. состояниям $T \geq T_c$.

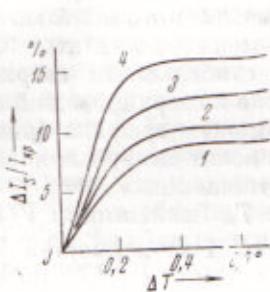


Рис. 3

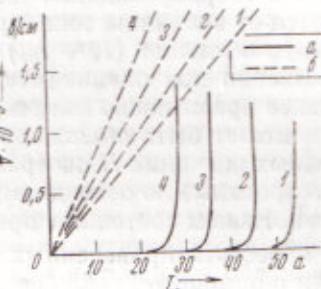


Рис. 4

Рис. 3. Зависимость $(I_s - I_{\text{кр}}) / I_{\text{кр}}$ от T при различных H :
1 — 20 кэ; 2 — 30; 3 — 40; 4 — 50 кэ

Рис. 4. Вольт-амперные характеристики сверхпроводника в резистивном состоянии при $T = T_c$ (a) и подложки (b) при различных H : 1 — 20 кэ; 2 — 30; 3 — 40; 4 — 50 кэ

Поскольку сопротивление сверхпроводника в нормальном состоянии на несколько порядков выше сопротивления меди и температурная зависимость меди при температурах ниже 10° К слабая, можно считать, что сопротивление медной матрицы

$$R_n = \rho / A \simeq (dV/dI)_{T=T_c}. \quad (6)$$

Отсюда понятно, что доля тока, текущая по медной матрице, составит

$$I_n = fI = V / R_n. \quad (7)$$

С учетом уравнения (7) легко можно найти ток, текущий непосредственно по сверхпроводнику, находящемуся в резистивном состоянии:

$$I_e = (1 - f)I = I - I_n = I - V / R_n. \quad (8)$$

На рис. 1 зависимости $V(I_s)$, соответствующие экспериментально полученным вольт-амперным характеристикам комбинированного проводника, показаны пунктирными линиями.

С другой стороны, тепловой поток, отводимый с единицы поверхности комбинированного проводника в жидкий гелий,

$$q = VI / (Pl) = h(T)[T_n - T_s], \quad (9)$$

где $P = \pi d$ — охлаждаемый периметр проводника, $l = 1$ см — длина исследуемого участка, T_n — температура проводника. Отсюда, используя ту или иную экспериментальную зависимость теплоотдачи в жидкий гелий, каждой точке вольт-амперной характеристики может быть приписана соответствующая температура проводника. Поскольку сверхпроводящие жилы тонки ($d_{\text{жила}} \simeq (7-10) \cdot 10^{-3}$ см) и связь их с медной матрицей является достаточно хорошей, полагаем, что $T_n = T_s$. На рис. 2 представлены зависимости $I_s = f(T_s)$ для различных значений магнитного поля, построенные с использованием кривой теплоотдачи $q(\Delta T)$, характерной для условий

охлаждения данного опыта ⁽⁷⁾. Соответствующие температурные зависимости критического тока $I_{kp}(H, T)$ исследуемого образца были получены в дополнительных опытах и также показаны на рис. 2. Температура образца выше температуры гелиевой ванны T_b обеспечивалась путем использования метода «перевернутого дюара» и регистрировалась с помощью термометров сопротивления. Отсюда легко получены значения отношения $(I_s - I_{kp}) / I_{kp}$ для различных значений внешнего магнитного поля (рис. 3).

Напомним, что в модели З. Стекли величина тока, текущего по сверхпроводнику, пропорциональна критическому току сверхпроводника при данной температуре. Таким образом, отношение $(I_s - I_{kp}) / I_{kp}$ показывает, насколько ток в сверхпроводнике для данного комбинированного проводника отличается от величины тока, предсказываемого моделью Стекли. Как видно из рис. 3, величина $(I_s - I_{kp}) / I_{kp}$ может достигать 10—15%, что весьма существенно при оценке степени стабильности сверхпроводящих устройств. Такое превышение величины тока в сверхпроводнике над критическим полем может быть объяснено с помощью графика (рис. 4), на котором для разных значений H изображены вольт-амперные характеристики подложки, построенные по очевидному соотношению $V_n = IR_n$, и сверхпроводника в резистивном состоянии при $T = T_b$. Зависимости $V(I_s)_{T=T_b}$ найдены путем пересчета приведенных на рис. 1 зависимостей $V(I_s)$; пересчет выполнен с помощью предложенного в работе ⁽⁸⁾ соотношения

$$I_s(H, V, T) = I_s(H, V, T_b) [1 - \tau / \tau_c]. \quad (10)$$

Из рис. 4 видно, что на начальных участках изотерм $V(I_s)$ сопротивление сверхпроводника в резистивном состоянии R_{res} существенно меньше сопротивления подложки R_n . Следовательно, в этой области состояний сверхпроводника параметр $x = R_n / R_{res}$ в уравнениях (3) — (5) оказывается сопоставимым с остальными величинами, входящими в уравнения. Это обстоятельство и приводит, в частности, к существенному отличию I_s от значения из модели Стекли, а следовательно, и к изменению остальных характерных параметров (f , $VA / (\rho I_s, \tau)$), описывающих состояние комбинированного проводника в условиях деления тока между сверхпроводником и подложкой.

В заключение авторы благодарят В. Б. Зенкевича, Н. А. Кулымова и В. В. Кургузова за плодотворные обсуждения полученных результатов и помощь в работе.

Институт высоких температур
Академии наук СССР
Москва

Поступило
16 XI 1970

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ Z. J. J. Stekly, I. L. Zar, Trans. IEEE, NS-12, 367 (1965). ² A. R. Kantrowitz, Z. J. J. Stekly, Appl. Phys. Letters, 6, 56 (1965). ³ M. G. Kremlev, V. B. Zenkevitch, V. A. Altov, Cryogenics, 8, № 3, 173 (1968). ⁴ В. В. Сычев, В. Б. Зенкевич и др., ДАН, 188, № 1 (1969). ⁵ Y. B. Kim, Proc. of the X Intern. Conf. on Low Temperature Phys., Moscow, 1966. ⁶ В. В. Сычев, В. А. Альтов, Изв. АН СССР, Энергетика и транспорт, № 5, 84 (1970). ⁷ M. N. Wilson, Adv. Cryog. Eng., 12 (1966). ⁸ W. F. Gauster, J. Appl. Phys., 40, 2060 (1969).